

日联科技集团股份有限公司

2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护全体股东利益，日联科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）制定2026年度“提质增效重回报”行动方案，现对2026年度“提质增效重回报”行动方案进行半年度评估如下：

一、专注主营业务，夯实领先地位

公司是国内工业智能检测领域龙头企业，主要从事工业智能检测设备及核心部件的研发、生产、销售与服务，产品和技术主要应用于集成电路及电子制造、新能源电池、铸件焊件及材料、食品异物等检测领域。报告期内，公司围绕“横向拓展、纵向深耕”“高端化、平台化、全球化”的发展战略以及建设“全球化的智能检测技术和高端检测装备的平台化企业”的发展目标，面向全球开展投资并购，持续整合全系电磁波谱和原子物理检测技术，为客户提供涵盖多模态检测技术的一站式解决方案。

2026 年是公司平台化发展的关键阶段。一方面，中国制造正向“中国智造”升级，众多高端制造领域对产品精度、可靠性要求大幅提升，倒逼企业加大工业检测投入；另一方面，工业检测设备中高端市场正演绎国产替代的产业逻辑；与此同时，新技术、新工艺、新场景正催生出包括半导体先进制程、先进封装、逻辑芯片、存储芯片、光模块、CPO、液冷、高端 PCB、固态电池、商业航天等大量新的检测设备需求，且多模态融合检测逐渐发展成为主流解决方案，国内工业检测设备行业正进入多重利好叠加的战略发展机遇期。公司坚持多维创新驱动，“技术领域×应用领域×垂直一体化布局”的乘数效应正在构建独特的竞争壁垒，全球化布局为公司中长期发展打开空间。报告期内，公司工业 X 射线智能检测设备上游的核心部件 X 射线源、AI 软件算法“一硬一软”的底层能力持续夯实，核心部件+软件+AI+检测设备及整体解决方案持续完善；通过投资并购，公司检测技术领域持续打开，加速打造工业检测设备平台型企业。与此同时，公司在集团层面开始推进跨业务主体的协同发展。公司围绕已有检测技术、产品能力边界持续拓展新的下游业务场景，积极拓展全球化制造能力及营销网络建设。

报告期内，公司实现营业收入 71,540.20 万元，同比增长 55.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 12,802.27 万元，同比增长 54.63%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,970.86 万元，同比增长 83.90%。

1、全系列 X 射线源产业化加速推进，在众多战略新兴产业检测领域取得重大进展

作为 X 射线智能检测设备中技术壁垒和价值量最高的核心部件 X 射线源，从产品类型覆盖度来看，公司已经实现了闭管微焦点射线源、开管射线源、大功率小焦点射线源等射线源的全谱系覆盖，是国内唯一一家实现了 X 射线源基础理论研究、关键材料掌控、复杂制备工艺、可靠性验证等方面全覆盖，且实现了全谱系工业用 X 射线源大批量产业化的企业，实现了关键核心部件的国产化替代。报告期内，公司新开发的纳米级开管射线源和大功率小焦点射线源等实现了批量出货，公司射线源自用渗透率及独立对外销售数量均持续提升。

在检测设备方面，公司持续进行设备开发迭代，各类标准化设备已有一百余款，实现了下游领域 3D/CT 检测技术全覆盖，设备价值量、竞争力持续提升，原位 CT 智能检测设备也已实现出货。同时，科技与能源已成为贯穿各类产业发展的核心主线，成为时代发展不可逆转的主旋律。新场景、新技术、新工艺带来对 X 射线新的检测需求，公司保持对产业趋势和技术趋势的前瞻性洞察，及时响应、提前布局，抢抓新的市场契机。

在高多层 PCB 检测领域，公司研发的 X 射线智能检测设备，实现高多层 PCB 内部结构及背钻工艺的可视化成像，同时兼顾检测精度与量产效率，是高多层 PCB 从研发验证到量产质控的核心检测设备，更是背钻工艺精准检测、批量质控的关键手段。目前，公司相关 X 射线智能检测设备已面向胜宏科技、鹏鼎科技、景旺电子等一二线 PCB 厂商实现出货，后续有望进入大规模放量阶段。

在半导体先进封装检测领域，公司研发的 X 射线智能检测设备，依托亚微米级分辨率微焦点 X 射线源与 CT 层析成像技术，实现半导体先进封装内部结构的三维可视化与微小缺陷精准识别，是保障先进封装良率的重要设备。目前，公司正在积极推进先进封装检测设备的客户验证及导入，报告期内，相关设备在静态测试、检测影像效果等方面反馈良好，正加速推进产业化及商业化进程。

在液冷板检测方面，公司研发的 X 射线智能检测设备，实现液冷板内部流

道结构、焊接质量的可视化检测，精准定位缺陷位置与类型，为密封性优化提供数据支撑，是液冷板量产质控的关键手段。目前，公司相关 X 射线智能检测设备已面向下游客户实现了批量出货，报告期内，相关业务收入较上年同期实现大幅增长。

在光模块检测领域，公司研发的 X 射线智能检测设备，可实现光模块内部芯片、金线键合、光纤对准等精密结构的高分辨率成像，兼顾无损检测、高精度与高速检测需求，是高速光模块量产质控的关键支撑。去年下半年以来，公司已联合数家下游厂商，应用相关 X 射线智能检测设备对其光模块样品进行试测，报告期内，相关设备已在国内某头部光通信企业实现订单层面的突破。

在固态/半固态电池检测领域，公司研发的 X 射线智能检测设备，实现半固态电池内部结构、缺陷的可视化检测，兼顾生产质控与全生命周期监测，是保障半固态电池安全性与性能的核心检测手段。目前，公司相关 X 射线智能检测设备已面向下游头部厂商实现出货。

2、持续加大 AI 技术研发投入，突破 AI 基础技术，驱动高端智能产品代际跃迁

报告期内，公司在影像软件领域坚持人工智能战略，持续加大人工智能技术研发投入，致力于在人工智能基础技术与关键应用领域实现突破，以此驱动检测终端智能化的代际跃迁。公司稳步推进人工智能算力基础设施建设，为前沿研发提供了强大引擎。在此基础上，公司持续迭代大模型基础技术，成功发布了业内首款工业 X 射线影像 AI 垂类大模型，实现了对海量影像与缺陷数据的深度理解与生成，有效驱动了公司在 X 光成像基础技术与 AI 检测基础技术上的源头创新，大幅提升影像质量和检测精度，AI 图像降噪、图像增强基础算法取得关键突破，实现更高精度成像，有效捕捉微观细节，适配多元化高精密检测场景。同时，公司在 CT 重建核心算法上也取得了原理性突破，实现了重建质量和重建速度的双重跃升，工业多场景 CT 重建算法和 AI 伪影校正算法均取得突破，成像细节与精度显著提升，可满足背钻、先进封装、存储芯片等高门槛业务需求，持续拓宽高端检测应用边界，构建了完整的人工智能技术体系。未来，公司将在 AI 影像软件领域持续加大研发投入，进一步拓宽公司在海量数据、算法智脑、算力中心及影像系统开发等领域构建的 AI 智算领先优势。

3、工业检测平台化能力显现，并购标的经营整合顺利向前推进

在收并购方面，公司坚持“横向拓展、纵向深耕”的发展战略，旨在突破日联科技现有的检测技术和服领域。横向拓展包括但不限于 X 射线的其他先进检测技术，重点在光学、超声、磁粉、涡流、能谱、中子、量子等检测技术。纵向深耕于亚微米和大功率 X 射线源，并实现磁控管、射频真空管、光电倍增管和探测器等关键零部件的技术突破。目前，公司正面向全球开展收并购动作，积极拓展其他工业检测技术，通过自研以及投资并购方式，在视觉、声学、多光谱、电性能等检测技术领域进行布局，与 X 射线检测技术形成协同互补，丰富公司检测解决方案，拓展公司业务边界，打造工业检测平台化能力。

截至本报告披露日，今年以来，公司投资了弥费科技，该公司是领先的半导体制造 AMHS 整体解决方案及核心零部件提供商。公司投资了超微量测，该公司是面向半导体先进封装及电子器件等领域的高分辨率超声检测系统及核心零部件提供商。公司投资了思朗科技，该公司是一家深耕于科学智能的高科技半导体独角兽企业，致力于国产高性能算力芯片的设计和应用，为科学智能提供自主可控的算力基础设施和行业高质量科学数据集。公司投资了中科驭数，该公司专注于数据处理加速技术领域，主要业务包括芯片研发、加速卡产品开发以及数据处理解决方案。公司投资了星河动力，该公司主要业务包括航天发射服务、航天装备制造、高性能产品配套，以及工程、技术、安全、系统集成等系统化解决方案。公司投资了马来西亚上市公司 QES，该公司主要从事半导体和晶圆检测、测试、测量、分析及自动化处理设备的制造、销售及相关整体解决方案服务。公司还和中微公司+澜起科技等成立私募基金智微凌峰，聚焦半导体、泛半导体和战略新兴领域，通过联动产业及金融资源，构建覆盖产业链上下游的生态投资体系。公司收购了翌锋电子，该公司是面向半导体制造及高端仪器所需的电子源开发与生产的科技型企业。公司对从事半导体测试设备的研发、生产和销售的菲莱测试的收购正在推进中，截至本报告披露日，公司对菲莱测试收购正在问询反馈阶段。

报告期内，公司控股孙公司 SSTI 正重塑增长动能。在研发方面，SSTI 成立新加坡研究院，面向全球招募一流人才，研发实力得到进一步夯实。公司已与某全球顶尖的半导体晶圆代工企业以及国内某头部存储芯片龙头在联合研发方面

达成了深度合作，为后续业务层面的合作深化创造了条件。在市场方面，SSTI 通过举办全球失效分析研讨活动、扩建销售和市场团队等方式，为打开国外及国内失效分析市场储备动能。截至本报告披露日，SSTI 在国外尤其是国内市场开拓方面取得了显著成绩。公司面向前述某全球顶尖的半导体晶圆代工企业、国内某头部存储芯片龙头、某全球科技巨头实现重复订单或订单突破，在手订单充裕，为后续业绩增长奠定基础。公司和 SSTI 成立的合资公司赛美康筹建工作顺利推进中，合资公司将从实现 SSTI 现有系列设备国内规模化生产制造以及开发产线级别设备等方面进一步打开增长空间。

报告期内，公司控股子公司珠海九源在上年“打基础、搭框架、建流程”的基础上，依托自研共直流母线专利技术以及锂电池电性能检测系统、矩阵式储能对拖测试系统、面向储能系统测试场景打造的电网模拟系统等不断完善的产品矩阵，加大市场开拓力度，在头部客户开拓、订单获取、市场影响力提升等方面进展明显。与此同时，在上市公司支持下，公司积极面向下游场景开发新技术新产品，构网型 PCS 技术及相关应用也已推出，公司在组织管理体系升级后正进入新的增长阶段。

报告期内，公司控股子公司翌锋电子在面向半导体制造及高端仪器所需的电子源研发与产业化方面取得诸多突破。翌锋电子主要研制单晶六硼化镧电子源以及热场发射（肖特基）电子源，此类电子源是电子显微镜、X 射线分析仪器、电子束增材制造、半导体量检测等多种高端电子束装备必不可少的核心元器件。报告期内，已成功实现多款仪器原装进口电子源的国产替代，正在积极配合国内 OEM 厂商开展国产高端装备的整机研发。

随着公司投资并购工作持续落地，以及并购标的经营整合顺利推进，公司工业检测平台型企业正逐渐成型。公司在推进对并购标的一对一的整合的同时，还开始推进上市公司与标的公司以及不同标的公司之间一对多或者多对多的协同式发展。例如，SSTI 在逻辑芯片测试领域积累了近 40 年的经验以及大量全球顶级的客户资源、在先进封装特定场景算法领域居于业内领先地位；收购正在推进中的菲莱测试，其老化可靠性测试技术和产品能力位于行业第一梯队；QES 全球渠道和客户资源优势明显。上市公司正统筹集团层面不同业务主体在研发、生产、供应链、客户、渠道等方面的“联合作战机制”，打破不同业务主体间的壁

全，实现集团资源优化配置，在加速构建检测生态、形成网络效应的同时，为未来五年高速增长创造条件。

4、全球化战略进展显著，为公司打造新的增长极

报告期内，公司进一步加大全球市场深耕力度，积极拓展海内外研发生产制造能力、销售渠道及服务网络，公司产品销售已覆盖全球 70 多个国家及地区。目前，公司已在全球范围形成“3+3”产业布局，在国内拥有无锡、重庆、深圳三大研发及生产基地，并在新加坡设立海外总部，在马来西亚、匈牙利、美国成立研发及生产基地，全球化布局已初具规模。截至报告期末，公司海外几大基地均已实现正常接单、生产、销售，运营逐渐步入正轨。未来，公司将继续积极布局海外市场，推动公司全球化发展，后续随着海外子公司产能提升，有望为公司贡献新的业绩增长点。

二、优化运营管理水平，提升经营质量与效率

1、提高经营效率

2026 年上半年，公司应收账款周转率为 1.50，存货周转率为 1.07。对于应收账款回款方面，公司通过加快出货设备的验收以提高回款速度，技术、生产和售后服务等部门全力推进设备的出货及快速验收，做好订单回款收款管理工作；对于存货周转方面，公司通过加强产品销售管理、减少存货投入、实施有效的库存控制等，以加快存货周转，提高公司的经营效率和竞争力。

2、提高盈利质量

公司持续进行市场拓展，继续践行自主研发、全球化市场发展战略，在立足国内市场需求的前提下，秉承“巩固国内、积极出海”的发展理念，积极适应国际形势，加强全球市场的开拓，着重在新技术、新产品和新领域开发，提高公司全球 X 射线智能检测设备及核心部件市场占有率，提高公司盈利质量水平。

3、优化考核要求

公司在运营管理中采用关键指标管理，尤其在销售管理、研发管理、生产管理和质量管理等方面设定了一系列的关键考核指标，覆盖了销售、技术、质量、效率和成本等方面。2026 年上半年，公司定期跟踪各项指标的执行情况，并根

据统计结果和客户反馈进行内部讨论，制定出关键指标的改进要求。

4、加强人才建设

为建立健全长效激励机制，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，充分调动员工的积极性和创造性，以进一步吸引和留住优秀人才，公司于 2024 年 4 月 26 日制定了 2024 年限制性股票激励计划，2026 年上半年公司完成了 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期的及预留授予部分第一个归属期股份过户登记工作，本期为符合条件的 156 名激励对象办理归属，对应限制性股票的归属数量为 118.34 万股。未来公司将继续执行股权激励计划，将公司利益、个人利益与股东利益相结合，有效的激励优秀人才，继续引进和培养各方面的人才，吸纳全球高端人才，优化人才结构。

2026 年上半年，公司通过一对一导师制、外部讲座、内部研讨会、线上学习等多种形式，内外训的结合方式实施培训计划，累计培训达 68 场。2026 年公司继续完善员工培训计划，形成有效的人才培养和成长机制，通过内外部培训、专题研究等方式，提升员工业务能力与整体素质，在鼓励员工个性化、差异化发展的同时，培养团队意识，增强合作精神，打造一流的人才团队，实现公司可持续发展。

三、完善公司治理，推动公司高质量发展

1、深化治理机制落地

公司已建立了由股东会、董事会和管理层组成的公司治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡的机制，并不断健全内部控制制度，持续规范管理层的权利义务，防止利用管理层优势地位侵害公司及中小投资者的权益。2026 年上半年公司共召开股东会 2 次，董事会 4 次，董事会专门委员会 8 次，确保股东能够充分行使权利，董事会及各专门委员会、独立董事、管理层能够认真履职，切实保障公司及中小股东利益。公司将持续优化治理体系，严格遵循法律法规及规范性文件要求，根据最新监管指引调整完善法人治理和内部控制制度，确保公司运作契合最新规范标准。

2、建立常态化学习机制

公司建立监管案例常态化学习机制，证券部不定期整理证券监管动态、典型违规处罚案例等，在管理层会议或内部工作群中进行通报学习，持续强化管理层及关键岗位人员合规意识，提升其对监管导向、市场环境及投资者关切事项的前瞻性研判能力。

四、持续加强投资者沟通交流

公司证券事务部是公司投资者之间沟通的专职部门，交流工作具体包括以下方面：

1、开展定期业绩交流

公司于2026年5月11日召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会，在定期报告披露之后，对经营业绩进行全面且深入的说明，详细解读定期报告的各项内容，通过设计“一图读懂日联科技”海报帮助投资者更好地理解公司的运营状况和财务表现。

2、健全常态化沟通渠道

公司持续健全日常投资者沟通机制，在日常工作中积极回应投资者关切，认真回复“上证e互动”平台提问，耐心解答投资者疑问。同时，实行投资者热线专人接听制度，确保投资者咨询渠道畅通、响应及时。通过持续、规范、高效的常态化沟通，公司与广大投资者建立起长期稳定、相互信任、和谐共赢的良性互动关系。

3、拓展多元化交流形式

2026年上半年，公司通过接待投资者走进上市公司进行实地调研、参加券商策略会、上门路演等多种形式加强与市场沟通，累计发布3份《投资者关系记录表》，累计与上百家机构及个人投资者进行了交流。

未来，公司将继续秉持着开放的心态，通过“上证路演中心”、“腾讯会议”、“上证e互动”、投资者热线等多种方式为投资者搭建多样化、高效畅通的沟通渠道，持续保持与广大投资者的良性互动，及时传递公司经营进展、技术突破与

回报规划，构建长期稳定、互信共赢的投资者关系。

五、持续完善投资者回报机制

公司坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分红的连续性和稳定性，根据公司的盈利情况、现金流状况以及未来发展规划等因素，制定合理的利润分配方案。2026年4月17日公司召开第四届董事会第十八次会议，2026年5月8日公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于2025年度利润分配方案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）。截至2026年6月10日，公司已完成权益分派，合计分派的现金红利总额为9,863.86万元（含税）现金分红金额占当年归属于上市公司股东净利润的56.03%。此外，公司于2025年6月23日制定了股份回购方案，拟以不低于1,000万元，不超过2,000万元的自有资金及银行贷款对公司股份进行回购用于股权激励，截至2026年6月1日，公司已完成回购，合计回购公司股份224,198股，使用资金总额1209.31万元。

未来，公司将根据实际情况，制定相应的分红方案，持续维护广大股东的合法权益，并结合公司的经营状况和业务发展目标，充分利用分红后留存的未分配利润和自有资金，保证未来经营的稳健发展，实现业绩增长与股东回报的动态平衡，打造可持续发展的股东价值回报机制。

六、其他事宜

公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施进展并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

日联科技集团股份有限公司

董事会